

2021年度 京セラ株式会社 募集要項

1. 採用予定

- 【応募資格】 2021年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)
- 【採用予定】 理工系 300名 程度
- 【採用学科】 電気・電子系／情報・通信系／機械系／制御系／化学系／材料系／物理系／その他
- 【求める人材像】
- ・ 夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
 - ・ 素直な心、ひたむきさを持っている人
 - ・ グローバルな視点を持っている人

《専攻分野と採用比率目安》

| 電気・電子系 | 情報・通信系 | 機械／制御系 | 化学／材料系 | 物理系 | その他 |
|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 25% | 25% | 25% | 15% | 5% | 5% |

2. 応募方法

(1) 推薦応募の方の応募方法について

修士・学部の方は「プロダクト・職種」から2つを選択いただき、ご応募ください。

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募概要」及び「自己紹介シート記入要領」をご参照ください。

ご本人が希望するプロダクト・職種への配属を前提に、マッチング面談・選考に進んでいただきます。

「マッチング面談会」では、ご本人が希望される「プロダクト・職種」と「技術専門性・応用性」(学部生の場合は“学業の理解度”と“ポテンシャル”)について、該当部門との適性を確認いたします。

※別紙「自己紹介シート記入要領」①～⑤の中から、第1希望/第2希望を選択してください。

※6月1日以降にご連絡いただく場合には、ご希望のプロダクト・職種への応募が出来ない可能性があります。予めご了承ください。

(2) 自由応募の方の応募方法について

選考方法が、学校推薦応募とは異なります。ご希望の方は、弊社新卒採用HPをご確認の上、ご応募ください。

(3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」を希望する方についても、学校推薦での応募を受け付けております。

応募・選考方法が技術コースとは異なりますので、ご希望の場合には弊社営業管理コース担当宛にご連絡ください。

連絡先は、技術コース担当と同じE-mail・TELになります。

(4) 留学生の方の応募方法について

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に弊社担当宛にご相談ください。

(5) 博士の方の応募方法について

随時、応募を受け付けております。ご希望の場合は、弊社HPから、マイページにログインいただき応募フローを確認してください。

ログイン後に、書類選考を行い合格された方にその後の選考に関してご案内いたします。

3月以前にご応募の場合は、直接ご連絡ください。

<技術コース お問い合わせ・採用書類送付先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

京セラ株式会社 人材開発課 技術コース担当

E-mail : kcsaiyou@kyocera.jp TEL : 075-604-3510 (直通)

※各コースへの応募書類をご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。

自己紹介シート記入要領

☆ 応募前に必ず弊社採用HPより、エントリーしてください。 URL: <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/>
 エントリー後、ご自身のマイページより「自己紹介シート」及び「成績情報」を入力してください。

<自己紹介シート必要情報の入力に際して>

(1) 「携わりたい技術分野」については、【◆表1 技術分野】から選択してください。(3つ以内)

(2) 「希望するプロダクト・職種」については、【◆表2 プロダクト・職種】から選択してください。

プロダクト名称①～⑤から、2つ選択してください。 ※1つのプロダクト・職種を強く希望される方は、1つだけでも構いません。

【携わりたい技術分野及びプロダクト詳細】

◆表1 技術分野

| | | | | |
|--------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| ・無機材料技術 | ・薄膜成膜技術 | ・パワーエレクトロニクス技術 | ・画像認識/画像処理技術 | ・振動/熱/流体関連技術 |
| ・有機材料技術 | ・微細加工技術 | ・電気特性評価技術 | ・ソフトウェア技術 | ・電池関連技術 |
| ・金属材料技術 | ・金属加工技術 | ・制御工学技術 | ・シミュレーション技術 | ・人工知能関連技術 |
| ・応用化学技術 | ・電気回路技術 | ・機械設計技術 | ・分析技術 | ・特許/知的財産管理技術 |
| ・材料特性評価技術 | ・電子回路技術 | ・機構設計技術 | ・信頼性工学技術 | ・情報システム管理技術 |
| ・セラミックプロセス技術 | ・高周波回路技術 | ・機械加工技術 | ・CAD/CAM技術 | ・施設環境管理技術 |
| ・電気化学技術 | ・情報通信技術 | ・光学設計技術 | ・IE/VE技術 | ・安全防災管理技術 |

◆表2 プロダクト・職種

| プロダクト・職種 | 専攻分野 ※該当する専攻分野がない方は、担当までご相談ください。 | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|------------|
| | 電気・電子/物理系 | 機械・制御/物理系 | 情報・通信系 | 無機化学・材料系 | 有機化学・材料系 | 金属・結晶・半導体系 |
| 産業・自動車用部品 | | | | | | |
| ①ファインセラミック部品 半導体・液晶製造装置用大型部品、サファイア単結晶製品、生活文化・産業機械用部品、環境・エネルギー関連用部品、医療機器用部品 等 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| ②車載用セラミック部品 エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、セラミックヒーター、圧電材料/部品、ペルチェ素子 等 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| ③車載カメラ 車載カメラモジュール、車載カメラ用部品(光学・電子・機構)、ソフトウェア 等 | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| ④液晶ディスプレイ 車載用液晶ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、産業機械用液晶ディスプレイ 等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑤アドバンスツール 切削工具:セラミック、超硬合金、複合材料切削チップおよび金属製ホルダ(ターニング、ミリング)、ソリッド工具、プリント基板用ドリル、工業用精密ナイフ 電動工具:ステイプラー、鉄筋結束機、工作機器(インバクトドライバー等)、ガーデン機器(エッジトリマー等)、清掃機器(高圧洗浄機等)、DIY製品 空圧工具:ファスニング、ステイプラー、ネイラー | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| ⑥光学用部品・機器 車載用・FA用・医療用・OA用・写真用レンズユニット、FA用・医療用光学ユニット 等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 半導体部品関連 | | | | | | |
| ⑦半導体用セラミックパッケージ <パッケージ> 半導体デバイス用パッケージ、通信デバイス用高周波パッケージ、電子部品用小型パッケージ、光半導体用パッケージ 等 <基板> 車載エンジン制御用セラミック基板、LEDランプモジュール用セラミック基板 等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ⑧半導体用有機パッケージ・電子回路基板 <パッケージ> サーバー・ルーター・携帯端末用多層パッケージ 等 <基板/配線板> 携帯端末・車載用通信モジュール基板、パソコン・携帯端末用高密度配線板、ハイエンドサーバー・通信システム用大型基板 等 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| ⑨ケミカル材料 <半導体関連樹脂材料> 半導体封止材料、半導体・電子部品組立材料、化成品、熱硬化性成型材料、機能性シート 等 | | ◎ | | ○ | ◎ | |
| 電子デバイス関連 | | | | | | |
| ⑩電子部品 コンデンサ、フィルムコンデンサ、水晶部品、コネクタ、高周波デバイス(SAWフィルタ、高周波通信モジュール 等)、パワーデバイス | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ⑪プリンティングデバイス(デジタル印刷/ライフサイエンス/先端材料応用) 高速商業用インクジェットプリントヘッド、サーマルプリントヘッド、トナー方式プリンタ用アモルファスシリコン感光ドラム、LED光源 等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| コミュニケーション・生活・環境 | | | | | | |
| ⑫通信機器 スマートフォン(携帯電話)、通信モジュール 等 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ⑬エネルギーデバイス 太陽電池、SOFC、蓄電池 等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ⑭医療機器 生体材料開発、再生医療開発、医療用デバイスの技術開発、医療・ヘルスケア関連機器のソフトウェア開発 等 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑮宝飾・応用商品 セラミック応用キッチン用品、セラミック応用ステーションナリー・日用品、再結晶宝石、ジュエリー 等 | | ◎ | | ◎ | ○ | ◎ |
| 生産技術開発・情報ネットワーク関連 | | | | | | |
| ⑯生産技術開発・精機 メカトロ技術開発、製造プロセス開発、生産設備/検査設備の開発・設計・製作、IoT/AI/センシング技術活用によるデータ解析、システム開発 等 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ⑰情報システム・ネットワーク 社内情報ネットワークシステムの企画・開発、保守管理 等 | ○ | | ◎ | | | |
| ⑱生産系システム開発・DX推進(AI・データサイエンティスト・データベース) AI、DS、IoT、量子アニーリング等の最先端技術を用いた基盤となる事業システムの設計・開発 等 | ○ | ○ | ◎ | | | |
| システム研究・開発関連 | | | | | | |
| ⑲エネルギー分野 HEMS(家庭用エネルギー管理システム)、リチウムイオン蓄電システム、SOFCシステム 等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| ⑳コンピュータービジョン/AI分野 組み込みソフト開発、IoT・センサーネットワーク等の情報基盤技術開発、ビッグデータ・ヘルスケア等のサービスアプリケーション開発、画像処理・画像認識・画像センシング技術開発、人工知能等の先端ソフトウェア技術開発、産業向け自動化システム開発、クラウドシステム開発 等 | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| ㉑5G/IOT分野 5G基地局・RSU(路側機)の研究開発と事業化、IOT向けのLPWAモジュール、ユニット開発、IOTのソリューションフレームワークの構築 等 | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| ㉒ADAS/モビリティセンシング分野 ADAS、自動運転のキーデバイスとなる車載システムの開発、物体認識カメラシステム、交通安全インフラシステム、モニターシステム 等 | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 解析・分析関連 | | | | | | |
| ㉓解析・分析 無機、有機材料の分析評価の技術開発、数値計算技術の研究開発、分子動力学、量子コンピュータ利用、データインフォマティクス等の基盤技術研究 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他技術関連 | | | | | | |
| ㉔特許・知的財産 事業戦略の一翼を担う知財戦略の立案・遂行、自社発明の権利化・保護、他社とのライセンス契約関連業務 等 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ㉕施設管理・環境管理・安全防災 省エネ推進、排水/環境管理、電気設備設計、保守、労働安全衛生管理 等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |

「プロダクト&職種別採用コース」 応募概要

※学校推薦応募をお考えの方に限定させていただきます。

STEP.1 マッチング面談会

◆マッチング面談会の内容：ご希望のプロダクトの部門責任者と面談

(1) 面談会申込方法

| | |
|--------------------------|---|
| 1.大学 ⇒弊社へご連絡 | 就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様より面談会参加希望学生を弊社担当までご連絡ください。 <面談会申込連絡内容> ①学生氏名 ②学部/研究科名 ③学科/専攻名 ④就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様のご連絡先をメール又はお電話で弊社担当へご連絡ください。 |
| 2.ご本人 ⇒弊社HPからエントリー | 弊社、新卒採用サイトからエントリーしてください。 <京セラ採用HP URL: http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/ > |
| 3.ご本人 ⇒マイページから応募データ入力 | 「マイページ」より、次の3点を入力し、データを送信してください。 ①「自己紹介シート」※面談資料として使用します ②「成績情報」※修士の方は学部分も必要です ③「面談結果連絡先(就職担当教授・キャリアセンター等)」 ※自己紹介シートについては、研究概要等も入力いただくため、時間を要します。入力の際は、余裕を持って行ってください。 |
| 4.ご本人 ⇒データ送信・連絡 | データ送信されましたら、弊社担当までメールにてご連絡ください。 |

(2) 面談会申込
3月から申込をお受けいたします。なお、プロダクトごと採用定員に達した時点で応募を締め切らせていただきます。

(3) 面談会開催日程
3月下旬、4月下旬、5月下旬に開催を予定しています。
日程の詳細は、ご応募いただいた方に直接ご連絡いたします。
※選択されるプロダクトによっては、面談が複数日に及ぶ場合もあります。

(4) 面談場所
原則、京都本社を予定しています。一部のプロダクトでは、別の拠点で面談を行う可能性があります。

(5) 交通費補助
遠方者につきましては、弊社規定により交通費を補助いたします。
(詳細は、面談日時のご案内の際に連絡いたします。)

(6) マッチング面談会参加準備

| | |
|--------------------|---|
| 1.弊社 ⇒ご本人へ日程の連絡 | 応募データ到着後、弊社よりSPI検査、面談日時・場所について、メールにて連絡いたします。 |
| 2.ご本人 ⇒SPI検査受検 | 面談日の2日前までに、テストセンターにて「SPI検査」を受検してください。 |
| 3.ご本人 ⇒面談資料作成 | ◆下記資料2点を、面談日までにご準備ください。 ①技術PR資料 (A4/1~3枚、形式自由) ⇒ご自身の研究内容についてのPR資料 ②自己PR資料 (A4/1枚、形式自由) ⇒研究内容以外で自分を紹介するPR資料 提出方法は、別途ご連絡いたします。 事前に送信いただいた「自己紹介シート」「成績情報」と併せて面談を実施いたします。 推薦書またはそれに準ずる資料を当日ご準備いただける方は、ご持参ください。 |

(7) マッチング面談会結果フィードバック
面談終了後、2週間以内に、マッチング結果を就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様へ電話又はメールにてフィードバックさせていただきます。

(8) 推薦書の発行
マッチングが成立した場合には、推薦書の発行並びにその他提出書類の準備をお願いいたします。

STEP.2 最終選考

◆最終選考内容：面接

(1) 最終選考にあたって

| | |
|--|---|
| 弊社 ⇒ご本人へ日程の連絡 | 最終選考日が決定次第、弊社より日時・場所をご本人へメールにてご連絡いたします。 <最終選考にご持参いただく書類> ①推薦書 ②修了見込証明書 ③健康診断書 ④成績証明書(学部・修士)の原紙 ※推薦書は、学部長・就職担当教授・指導教授のどなた様からでも構いません。 宛名は、「人材開発部長 大西 実宛」でお願いします。 |
| <選考に際しての注意事項> ◆大学の都合により、マッチング成立後、推薦の決定または推薦状の発行までに日数がかかる場合には、事前に弊社担当へご相談ください。 | |

(2) 最終選考日程
6月以降随時

(3) 最終選考場所
横浜、京都、博多を予定

(4) 交通費について
最終選考については、弊社規定によりご自宅から面接会場までの交通費を全額支給いたします。

<技術コース お問い合わせ・採用書類送付先>
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課 技術コース担当
E-mail : kcsaiyou@kyocera.jp
TEL : 075-604-3510 (直通)
※各コースへの応募書類をご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。

「6月1日以降に学校推薦で応募をされる場合の留意事項」

- ①配属先のプロダクト、職種を限定しない応募方法に変更になる可能性があります。応募の際に弊社担当までお問い合わせください。
- ②推薦応募が決定されましたら、就職担当教授様もしくはキャリアセンターご担当者様から弊社担当までご連絡ください。
- ③応募書類については、「マッチング面談会申込方法」と同様にマイページからデータ入力・送信を行ってください。